

产品采购指南

半导体

第25届中国国际光电博览会

2024年9月11-13日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



扫码免费领取门票



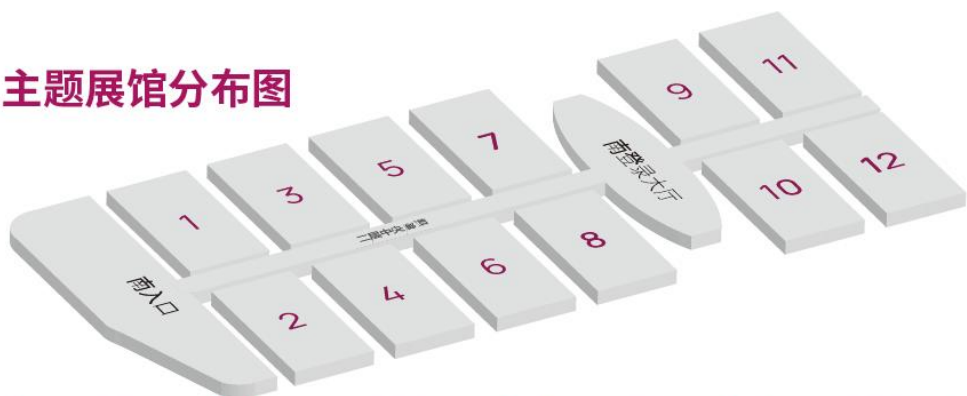
CIOE
中国光博会



光电大展 9月11-13日
深圳国际会展中心(宝安)

展示面积:240,000m² | 专业观众:120,000+ | 参展企业:3,700+

主题展馆分布图



9号馆

信息通信展

综合布线馆

光器件
光纤光缆/电线电缆
FTTX新一代光纤网络
数据中心
车载以太网

10号馆

信息通信展

半导体及光通信智能装备馆

测试测量/仪器仪表
信息传输设备
封装设备
半导体生产与制造

11号馆

信息通信展

通信器件模块馆

芯片设计
化合物半导体/光芯片/元器件
组件/模块
汽车光通信

12号馆

信息通信展

通信器件模块馆

芯片设计
化合物半导体/光芯片/元器件
组件/模块
汽车光通信

1号馆

精密光学展

摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用展

光学镜头
摄像模组
摄像头智能化AA设备

3号馆

精密光学展

摄像头技术及应用展

摄像头技术及应用展

光学测量测试
光学模造非球面技术展区
蓝宝石加工、应用
机器视觉及工业自动化

5号馆

精密光学展

摄像头技术及应用展

精密光学加工馆

超精密纳加工
光学元件
光学材料
光学加工设备

7号馆

精密光学展

摄像头技术及应用展

光学真空镀膜馆

光学镀膜材料
功能薄膜、镀膜元件
光学镀膜设备区

2号馆

激光技术及智能制造展

新型显示技术展

激光设备
自动化装备
显示材料/面板/模组
显示制造装备
AR/VR产品及创新应用

4号馆

激光技术及智能制造展

激光器

激光配套
激光医疗美容展区

6号馆

智能传感展

光电子创新展

激光雷达
3D视觉与成像
工业传感器及测量
MEMS及传感器
科研院所、高校及专精特新企业

8号馆

红外技术及应用展

红外热成像技术及应用
红外测温材料
红外传感器
紫外技术及应用
红外测试测量

产品类型	同期展会	页码
半导体材料		
晶圆	光电子创新展/精密光学展/红外展	8
陶瓷	信息通信展/精密光学展/激光及智能制造展	9
靶材 / UV减粘膜	精密光学展/新型显示展/信息通信展	10
抛光液	精密光学展/红外展	11
砂轮	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	12
研磨垫	精密光学展/信息通信展	13
基板	光电子创新展/激光及智能制造展	14
光刻胶/键合胶	光电子创新展/新型显示展/激光及智能制造展/精密光学展	15
模具材料 / 焊料	精密光学展/信息通信展	16
半导体设备		
光刻技术/光刻机	光电子创新展/传感展/精密光学展/激光及智能制造展	18-19
耦合机	信息通信展/激光及智能制造展	20-21
键合机	信息通信展/激光及智能制造展/红外展	22
固晶机	信息通信展	23
试验机 / 芯片测试机	信息通信展	24
贴片机	信息通信展	25
减薄机 / 贴装装备	信息通信展/精密光学展/光电子创新展	26
抛光机	精密光学展/光电子创新展	27

产品类型	同期展会	页码
研磨机	精密光学展/激光及智能制造展/信息通信展	28
清洗机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	29
划片机	精密光学展/信息通信展/激光及智能制造展	30
光谱仪	激光及智能制造展/精密光学展	31
蚀刻机 / 等离子去胶机	精密光学展/信息通信展	32
切割设备	激光及智能制造展/信息通信/精密光学展	33
钻孔&固化设备	激光及智能制造展/精密光学展	34
显示设备	新型显示展	35
检测设备	激光及智能制造展/信息通信展	36-37
轮廓仪	精密光学展	38
测量仪	信息通信展/精密光学展/智能传感展	39
真空镀膜设备	精密光学展/新型显示展	40
焊接设备	激光及智能制造展/信息通信	41
半导体配套产品	激光及智能制造展/精密光学展	42
光电子器件		
光芯片/电芯片	信息通信展	44-45
传感器		
工业传感器	智能传感展	47
MEMS传感器	智能传感展/红外展	48

相关主题指南推荐——智能制造

更多产品采购指南——
智能制造、数据中心
医疗、安防、消费电子
智能汽车、科研院所
绽放科研之光



重点推荐您查阅【智能制造】产品采购指南，产品内容包含：

生产制造设备

- 1) 激光制造：激光加工设备、智能装备与自动化、工业机器人
- 2) 光学加工制造：光学加工设备、摄像头生产设备
- 3) 光学镀膜：光学镀膜设备、光学镀膜材料
- 4) 新型显示：显示制造装备

测试测量及检测

光通信仪器仪表、光学测量仪器、传感测试测量仪器、红外测试测量仪器……

核心器件

激光雷达、激光器、
工业传感器、工业相机、
镜头&模组、机械加工及数控……



扫码下载智能制造指南电子版



重点展示半导体材料

展示范围：晶圆、陶瓷、靶材、UV减粘膜、抛光液、砂轮、研磨材料、基板、光刻胶、模具材料、焊料

晶圆

广州绿晶玻璃有限公司

5B82

玻璃晶圆

我司可提供各尺寸厚度及多种材质的光学玻璃晶圆，具有出色的耐热透光性能、良好的化学稳定性、较高的面型精度及表观质量，符合常规的加工要求和工业标准（SEMI等），主要应用于微光学、MEMS、晶圆级封装、生物工程以及各种指定应用。



半导体材料

深圳市唯锐科技有限公司

8B16

VIGO公司III-V族
/VCSEL/InGaAs外延晶圆

波兰VIGO公司成立于1993年，拥有一支超过30年红外探测器研究经验的资深专家队伍，是MCT/InAs/InAsSb探测器的领先设计者和制造商，提供低温制冷的红外探测器、III-V族外延片，覆盖1-16 μ m光谱范围，同时提供探测器模块、前置放大器、TEC温控等组件和解决方案。提供VCSEL晶圆和InGaAs晶圆。

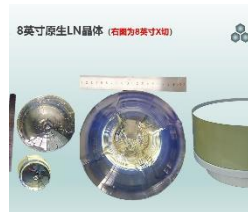


苏州匀晶光电技术有限公司

4D225

3~8 英寸铌酸锂晶圆片

3~8英寸 铌酸锂 晶体及晶圆 3~6英寸 MgO:LiNbO₃ 晶体及晶圆 3~4英寸 掺杂铌酸锂晶体及定制化晶圆。



浙江罗克光电科技股份有限公司

3A63

衬底及封装级玻璃晶圆

提供各尺寸各厚度玻璃晶圆，应用广泛



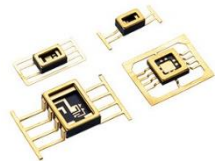
陶瓷

六安鸿安信电子科技有限公司

12D28-2

CSOP陶瓷封装管壳

CSOP(Ceramic small outline package)陶瓷小外形封装是一种小型化的贴装外壳,其翼型引线更有利于吸收外壳与PCB之间的应力,提高可靠性。广泛应用于放大器、驱动器、存储器、比较器等。



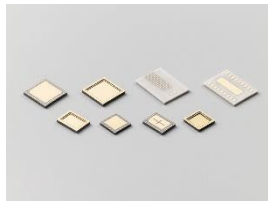
半导体材料

株洲艾森达新材料科技有限公司

11B11-2

HTCC

高温共烧陶瓷即为HTCC(High-temperature co-fired ceramics),主要以氧化铝或化铝生瓷带和、组、等高点金属浆料为主要原料,通过丝网印刷的方式将浆料印周在生瓷带上构成金属电路,并采用通孔填孔的方式使上下层导通,再进行多层叠合和高温烧结(其中氧化铝HTCC烧结温度在1500以上,氮化铝HTCC烧结温度在1800以上),最后经过电镀、烧焊等工艺,形成一个三维布线系统的单片结构,具有耐腐蚀、耐高温、寿命长、高效节能、温度均匀、导热性能良好、热补偿速度快等优点。



厦门新瓷材料科技有限公司

7C28

激光陶瓷反射体/漫反射体

陶瓷反射体广泛应用于激光泵浦腔中,与镀金反射体比较最大优势在于其使用寿命极长。我们提供各种型号的灯泵浦固体激光器用陶瓷体、半导体泵浦模块专用陶瓷体和美容和光子嫩肤用陶瓷体等。高反射率陶瓷材料在可见光区(380nm—780nm)光谱平均反射率高达97%以上。



有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 7B33

陶瓷靶材

可用于制备透明导电薄膜、各类光学薄膜、固态电解质薄膜、热障涂层、可燃毒物涂层、吸气薄膜、耐磨防护涂层、相变存储薄膜等,提供各种高纯、高密度氧化物,硅化物,碳化物,硫化物,硼化物,氟化物,难熔金属合金,贵金属合金,复合陶瓷化合物等,应用于平板显示、集成电路、全固态锂离子电池、电真空、功能涂层、相变存储器件等领域的研发及生产。



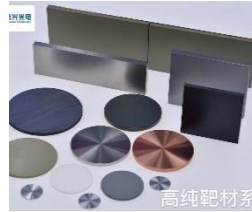
靶材/UV减粘膜

福州市诺兴光电材料有限公司

7B29

高纯金属靶材

我司生产并销售高纯磁控溅射领域的贵金属靶材、金属靶材、合金靶材、陶瓷靶材、定制化掺杂靶材、特殊功能靶材等。



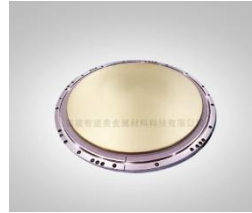
半导体材料

福建有道贵金属材料科技有限公司

7E41

金靶

有道可提供多行业使用金靶，金靶纯度包含4N/5N，晶粒尺寸可稳定控制在100um以内，均匀且细腻的微观组织可以保证极佳的镀膜效果。同时提供靶材绑定及回收服务，绑定焊合率可控制在97%以上。客户使用的金残靶可回收再利用用于置换新靶材避免受黄金价格波动影响成本。靶材出货前会经过纯度/晶粒/焊合率/内部缺陷/尺寸/表面粗糙度等多项检测确认合格后确保客户使用过程的稳定。

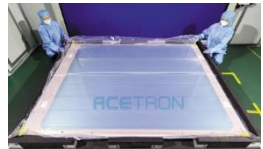


福建阿石创新材料股份有限公司

7B42

溅射靶材

阿石创提供各类金属、非金属、合金及化合物材质的溅射靶材，包括平面溅射靶材及旋转溅射靶材两大类，应用领域包括平板显示、TP、精密光学、太阳能、装饰镀膜、光磁存储等。



郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

5C25

UV减粘膜

UV减粘膜是一种特种胶带，其常态下具有很强的粘性，经UV光照射后粘性急剧降低，通常用于工件研磨、切割等制程的支撑及保护。



抛光液

大连国茂材料科技有限公司

5C62

日本Baikowski抛光液

Baikowski 提供多种抛光浆料。可应用于氟化钙、氟化钡、硒化锌、硫化锌、砷酸锂、锗、硅等晶体。HK系列的金刚石抛光液针对氮化镓和碳化硅晶圆片的抛光进行了优化处理。快速的去除率，优秀的表面光洁度。Baikowski 将会在抛光浆料的选择上提供帮助，并根据您的需要进行抛光浆料的定制。



包装方式：
200L 桶装

半导体材料

包头市昊锐稀土有限公司

510

抛光液

适用于盖板玻璃，硬盘玻璃，触摸屏，蓝玻璃，光学玻璃等的高性能抛光。



德米特（苏州）电子环保材料有限公司

7D65

TJX438系列精密光学/CMP抛光液

光学纳米级抛光粉，主要用于精密光学/半导体/玻璃硬盘等的高端CMP抛光。粒度达到纳米级分布均匀，分散性好，再工作界面的悬浮性保持的很好，兼具一定切削能力的同时又能满足超高表面光洁度的要求。



东莞市粤成新材料有限公司

7D11

二氧化硅抛光液

采用高纯硅溶胶为原料，经特殊工艺和配方制成，可根据不同的产品和抛光要求配制。主要用于：光学玻璃、蓝宝石、陶瓷、硬盘、半导体、金属等材质抛光。



砂轮

上海秉宝实业有限公司

3C12

FSK精密磨削砂轮

FSK有轴砂轮，日本国内生产数量市场占有率63%（2022年实际情况），产品在「汽车燃料喷射孔」以及「轴承」等要求高度持久性的领域内也被长年采用。塑料粒子：日本三菱瓦斯EP系列高折射率粒子；日本JSR耐高温耐黄变ARTON系列粒子。



半导体材料

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

5C25

LED背减薄砂轮

用于LED行业外延片背减薄加工，稳定配套日本、韩国、台湾主流研磨机，可加工2寸、4寸、6寸外延片。减薄效率高，表面质量好。砂轮质量稳定，不易深刮、碎片。砂轮寿命高，具有极高性价比，可大幅降低单片加工成本。砂轮主要性能已达到或超过进口同类产品水平。



上海号角精密工具有限公司

10B108-10B110

SiC减薄砂轮

应用场景：硅晶圆，SiC晶圆，氮化镓，铌酸锂等材料的减薄磨削 性能优势 *微气孔陶瓷结合剂实现高效磨削 *精筛磨料粒度，获得低损伤和良好的表面质量 *多种粒度，多种结合剂可选择，满足不同材料和不同精度产品加工要求 *响应速度快，快速迭代新材料磨削方案



昆明龙誉恒光电辅料有限责任公司

5C31

筒形砂轮

用途：用于光学玻璃镜片的粗磨削加工，去除玻璃表面硬质层，并加工出所需面形。特性：切削性非常好、加工效率高、自锐性好、稳定性强；规格：磨料层外径（D） $\phi 4\text{mm} \sim \phi 100\text{mm}$ ；内径（D1） $\phi 2\text{mm} \sim \phi 96\text{mm}$ ；高度（H）： $5\text{mm} \sim \phi 10\text{mm}$ 金刚石粒度：35#~400#；注：外径、内径、高度、底座均可按客户要求来进行订制。



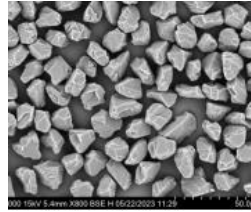
研磨材料

柘城县施诺德钻石科技有限公司

7E07

晶密® 精加工研磨用
金刚石微粉系列

原料采用自锐性好的RVD金刚石，TI检测结果稳定。采用特殊的破碎整形加工工艺，晶型呈较规则块状，饱满度高，片状率低、长径比小，棱角突出，粒度分布较为集中，大颗粒控制严格，加工精度高。产品的强度检测和磨削效率检测结果稳定，能满足大部分应用场景，是一种性价比高的精加工研磨用金刚石微粉。适用于制作树脂或陶瓷结合剂制品，金刚石聚晶，研磨液等，用于精加工研磨硬质合金、陶瓷零件，蓝宝石，半导体，玻璃，钻石，石材等。



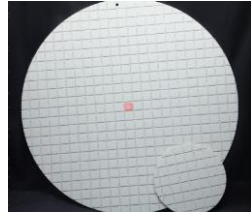
半导体材料

东莞励治研磨科技有限公司

3B82

CMP研磨垫

SUBA(白垫)，具有高移除率，高平坦性，低缺陷性与高性价比等优势。因具有特殊微孔结构，对研磨液具备优良保持性，同时因研磨垫具有适度之刚性以及良好的研磨再现性，可提升制程的稳定性与尺寸精密度。适用于半导体，光学元件、晶体、金属和玻璃材料的终道抛光。也可用来抛光特殊材质、硅、锗、砷化镓、陶瓷等产品。



河南联合精密材料股份有限公司

3A75

研磨垫

提供多种金刚石研磨(抛光)产品，包括油基、水基、醇基等不同的载体类型，多晶金刚石、单晶金刚石、纳米金刚石等多种磨料种类，为不同材料、不同要求的精密研磨抛。



深圳市新誉通光电有限公司

9D93

光纤研磨片

公司生产的研磨纸及研磨液系列产品能够满足各类光纤连接器，跳线，陶瓷插芯，光有源器件，光无源器件，MTR-MPO器件的研磨需求。



基板

长春长光精瓷复合材料有限公司

6B110-4

碳化硅散热基板

碳化硅散热基板，具有导热率高、热稳定性好、尺寸稳定性高等特点，与硅半导体材料性能匹配，可用于CMOS等大规模集成电路器件、大功率模块等散热安装基板。



半导体材料

神光光学集团有限公司

5B89

LCD掩模基板

LCD掩模基板使用石英玻璃作为材料，光学透过率高，热膨胀率低，相比其他玻璃更为平整和耐磨，使用寿命长，主要用于高精度掩模版。



金川岛新材料科技（深圳）有限公司

4C201

厚膜印刷陶瓷基板

运用丝网印刷技术，采用多层印刷方式将银浆、玻璃釉印刷在陶瓷基板上，经高温烧结形成陶瓷金属化。



株洲艾森达新材料科技有限公司

11B11-2

氮化铝基板

由于氮化铝（AlN）陶瓷基板所具有作为新一代的高导热性材料，越来越受到人们的关注和重视，是新一代LED照明、大规模集成电路、半导体模块电路及大功率器件理想的散热和封装材料。优良的热传导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介质损耗、接近于硅(Si)的热膨胀率。



光刻胶/键合胶

苏州研材微纳科技有限公司

6D115、6D116

光刻胶

光刻胶又称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的有机化合物溶液。其组成部分包括：光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂、单体、溶剂和其他助剂。光刻胶在受紫外曝光后，在显影溶液中的溶解度会发生变化。晶片制造中所用的光刻胶通常以液态临时涂覆在表面，而后被干燥成胶膜。通过曝光来传递设计图案。研材提供紫外光刻胶，电子束光刻胶，微流控应用光刻胶，LIFT-OFF应用光刻胶，临时/永久键合胶，封装用PI等光刻胶。



半导体材料

璞璘科技（杭州）有限公司

2A117

全系列纳米压印材料

热固化纳米压印光刻胶、普通紫外光固化纳米压印光刻胶、紫外光固化纳米压印和光刻两用胶、抗氧紫外光固化纳米压印材料、抗蚀紫外光固化纳米压印材料、高折射紫外光固化纳米压印光刻胶、喷涂式紫外光纳米压印光刻胶材料、快速模板胶材料、表面处理材料：防粘剂、增粘剂等。为客户量身打造专业用途的纳米压印胶材料。

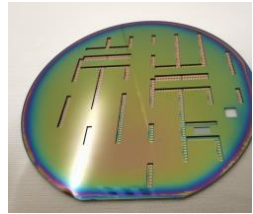


西安励德微系统科技有限公司

6C138、6C139

特殊材料键合

工艺解决方案：特殊材料晶圆键合 关键参数：键合温度 $>400^{\circ}\text{C}$ 、压力 $>25000\text{N}$ 应用场景：硅硅直接键合、石英键合、蓝宝石键合、玻璃键合、多层阳极键合MEMS器件、晶圆级封装、真空场景传感器

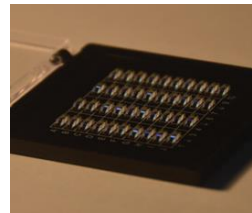


福州星科光电有限公司

4D110

RGB 合光键合体

这个RGB耦合棱镜体积小，可以将RGB耦合输出，输入通道间隔1.5mm，输出功率能到800mW，适合用在AI或者是半导体的制造设备中，产品性能优越，稳定。也可以根据不同用途做设计更改。



半导体材料/焊料

东莞壹德贸易有限公司

1D02

光学玻璃镜头模具材料

碳化硅或是金属陶瓷复合材料SS系列制作的精密光学玻璃陶瓷模具 可以大幅提升产品良率 SA系列使用于精密设备的大型部件 大幅减轻重量 快速的震动衰减 大量使用于高阶数控加工机床与新型光刻机



半导体材料

深圳市博金硬质工具有限公司

7A12

0201编带冲孔模具

微型元件载带方孔冲模，替代日本进口；最低寿命达一亿次，还适应不同的纸带材质，很受客户欢迎。

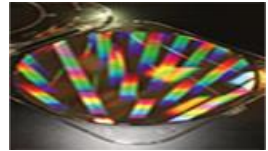


杭州欧光芯科技有限公司

2A134

模具

纳米压印模具，提供纳米压印所需的原始模具，子模具及工作模具加工服务。根据客户要求，使用电子束直写，光刻，刻蚀等多种加工工艺，为客户定制模具。



成都佩克斯新材料有限公司

12B722

预成型合金焊片
Solder Performs

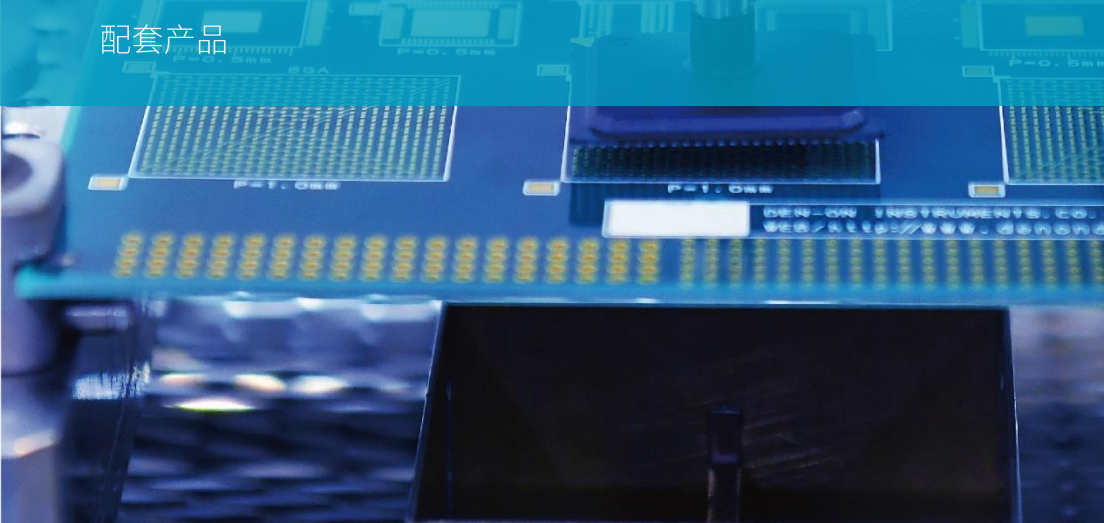
佩克斯新材料预成型焊片是一种表面平整的焊料薄片，常用于陶瓷、可伐合金、芯片、IC封装、金属管壳等之间的焊接。我们可以根据客户的需求，定制成各种形状的预成型焊片，包括长条箔带、长方形、正方形、方形框、圆形、圆环形、椭圆形及非标准形状等等。





重点展示半导体设备

展示范围：光刻技术/光刻机、耦合机、键合机、固晶机、试验机、贴片机、减薄机、贴装装备、抛光机、研磨机、清洗机、划片机、光谱仪、蚀刻机、等离子去胶机、切割设备、钻孔设备、固化设备、显示设备、检测设备、轮廓仪、测量仪、真空镀膜设备、焊接设备、配套产品



光刻技术/光刻机

托托科技（苏州）有限公司

2E006、2E007

无掩模板紫外光刻机

无掩模光刻设备基于空间光调制器的技术，实现了高速、高精度、高灵活性的紫外光刻。光刻机的分辨率和套刻精度决定了所制造的集成电路的集成度，这是光刻机品质的关键指标。



深圳市蓝星宇电子科技有限公司

6B102、6B103

准分子激光器/激光光刻机

准分子激光器/激光光刻机，微纳加工，最小线宽0.3UM。



Stella International Corporation Limited

6A22

DWL多功能专业型灰度光刻机

DWL系列灰度光刻解决方案：高分辨率的激光直写光刻机，拥有多种选配功能；具有快速灵活的高分辨率达到灰度光刻的专业表现，能在厚光阻中创建复杂的2.5D微结构。



维易尔半导体科技

10D36

UTW-2000A涂胶显影设备

UTW-2000A涂胶显影设备是一种结构紧凑，产能较高的半导体生产前道设备是半导体器件、集成电路制造的专用设备之一。其作用是通过控制精确的高速旋转系统将光刻胶均匀的涂敷在基片表面，并通过加热板加热使光刻胶固化，以完成基片自动涂胶的功能，再经过光刻机曝光后通过本机的自动显影功能去除感光胶，从而制造出集成电路的基本图形。该台UTW-2000A涂胶显影设备具备全自动的涂胶、显影、烘干及冷却等各项功能。



光刻机

矽万（上海）半导体科技有限公司

2D068、2D069

大幅面激光直写光刻机

Maximum Exposable Area:1000*1000mm² Light Source: 405nm GaN Laser Diode Maximum Write Speed:280mm²/min Minimum Feature Size:600nm



江苏雷博微电子设备有限公司

10D22

SS6-CA全自动光刻机

最大曝光面积：160mm*160mm，曝光分辨率：1μm（胶厚≤1μm的正胶），对准精度：±1μm（标准晶圆抛光片），光源强度:35mW/cm²，曝光波长：LED光源（进口灯珠，寿命约2万小时），曝光方式：定时（倒计时方式），掩模样片相对运动范围：X：优于±5mm；Y：优于±5mm；θ：优于±6°，掩模尺寸：7英寸，样片规格：6英寸（晶圆片），数字设定对准间隙和曝光间隙，掩模样片分离间隙：连续可调，对准方式：自动对准，可根据客户需求，增加对准标记的类型，累计不超过4组



科毅科技(东莞)有限公司

4B007、4B008

3DIC全自主知识产权
半自动/全自动光刻机

曝光光源：350W、500W、1KW、2KW汞灯/UV-LED 晶圆尺寸：2吋-12吋 均匀性：±3%和 ≤±5% 分辨率：0.5μm 对准精度：1μm 产能：≥70wph



青岛天仁微纳科技有限责任公司

2A103

研发型多功能纳米压
印光刻设备

GL4 R&D是一种专门为大学、科研院所和企业产品研发所设计，功能强大的多功能研发型纳米压印光刻设备。通过简单的夹具更换，可以实现旋涂压印胶高精度纳米结构压印和点胶大矢高结构自动找平压印模式之间的快速切换。可实现直径100mm以下基底面积上高精度（优于10nm*）、高深宽比（优于10比1*）以及微透镜阵列等微纳结构压印，适合用作紫外纳米压印光刻工艺开发，器件原型快速验证，纳米压印材料测试等研发。



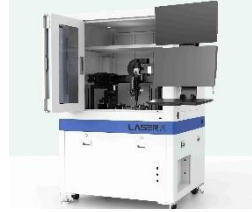
耦合机

镭神技术（深圳）有限公司

10C79

纳米级耦合设备——
双lens耦合机

作为成熟型的双六轴设备，可为客户提供各种类型的系统配置，适用不同类型的物料耦合；适用耦合类型物料：lens, AWG, FA, Z-Block, 光纤, 准直器等；模块化设计，可根据客户需求提供最佳配置，有效降低生产成本，高精度耦合系统，复定位精度±50nm，能满足高耦合效率的需求，配置图像系统，可多维度定位物料的位置角度，精准对位实现高效耦合；具备自带校准功能，减少人员调试时间和不同人员调试的差异，同时也降低了调试人员的要求。



半导体设备

骏河精机科技（上海）有限公司

10C31

波导耦合（被动元件耦合）系统

通过为耦合系统专用开发的滑台组合与软件。配合客户的装置，为您提供最适合装置的建议。高速耦合独创算法实现高速化操作性提升。通过对话型介面，提升软件操作性。除此之外，骏河可以根据客户的多样化需求提供个性化的定制解决方案，特别在高精度的组装和测试领域，骏河具有多年的丰富经验和精湛技术，将全力助力于实现工业4.0目标。



武汉来勒光电科技有限公司

4C198、4C199

蝶形激光器自动耦合系统

蝶形激光器自动耦合系统是武汉来勒光电科技有限公司自主研发的一款基于蝶形封装器件的自动耦合设备。用于光纤穿入到蝶形封装外壳内部进行耦合的一种自动耦合设备，很好的解决了光纤准确穿插、柔性夹持和高效耦合等难题。



武汉红星杨科技有限公司

4C030

耦合对准系统

耦合对准系统包含自动耦合系统、手动耦合系统，耦合位移台，耦合夹具器件。



耦合机

东莞市耀野自动化有限公司

10C26

透镜耦合机

用于各种高精度透镜 (LENS) 耦合, XYZ 三轴由直线电机+光栅尺组成, 分辨率5纳米, 重复定位精度20纳米。自动拾取透镜, 自动耦合, 自动点胶, 自动分段UV固化。具备全自动视觉定位, 真空机械二合一透镜夹, 均为行业先进水平。有伺服电机版的低成本方案供选择。



湖南中南鸿思自动化科技有限公司

10B73

FAC自动耦合封装设备

设备功能: 用于半导体激光器泵浦源中快轴准直透镜的自动耦合封装。可实现FAC透镜的自动拾取、姿态调整、光斑耦合、精确点胶以及UV固化。采用高速高精度直线电机, 具有高工作节拍与效率。

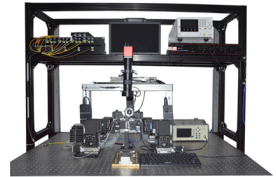


深圳光泰通信设备有限公司

10B56

AWG & PLC波导芯片耦合系统

1、半自动六维电动直线轴和六维手动旋转轴进行控制, 全自动十二维电动轴, 特殊算法快速找到最佳信号位置。2、兼容石英玻璃基和硅芯片材料, 兼容平行和垂直方式耦合。3、流程化操作, 具有调平衡功能, 兼容各种类型的AWG/PLC产品耦合。4、自动找光时间<15秒, 耦合重复性<0.1dB。5、压力传感器自动控制胶层距离(精度2 μ m), 保证重复性和一致性。6、自动点胶, 自动UV, 耦合异常自动报警等先进的耦合功能。

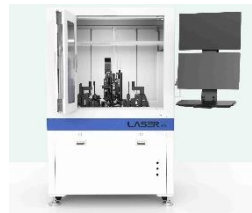


镭神技术 (深圳) 有限公司

10C79

纳米级耦合设备——双FA耦合机

作为成熟型的双六轴设备, 可为客户提供各种类型的系统配置, 适用不同类型的物料耦合; 适用耦合类型物料: lens, AWG, FA, Z-Block, 光纤, 准直器等; 模块化设计, 可根据客户需求提供最佳配置, 有效降低生产成本, 高精度耦合系统, 复定位精度 \pm 50nm, 能满足高耦合效率的需求, 配置图像系统, 可多维度定位物料的位置角度, 精准对位实现高效耦合; 备自带校准功能, 减少人员调试时间和不同人员调试的差异, 同时也降低了调试人员的要求。



半导体设备

键合机

北京华奥复兴科技有限公司

4D088

多功能键合机

多功能键合机是一款用于芯片和基板之间电气互联和芯片间的信息互通的手动键合设备，该设备基于超声键合原理，通过精密的机械结构和高度集成的硬件软件控制，实现引线与基板焊盘的紧密连接，设备具有球焊和楔焊两种功能，可用于金丝、铂金丝、铜丝、银丝、铝丝、金带等多种类型引线的键合，广泛适用于半导体器件的实验室研发、产品原型试产、产品评估、产品返修等。



半导体设备

苏州研材微纳科技有限公司

6D115、6D116

晶圆键合机

键合晶圆尺寸：4英寸、6英寸、8英寸； 最大压力：10kN、20kN、30kN（大压力可定制）； 压力均匀性：±5%； 温度范围：可升至450°C（高温可定制）； 温度均匀性：±2%； 极限真空： 1×10^{-3} Pa； 其他：可根据客户需求定制



吾拾微电子（苏州）有限公司

10C23

键合解键合机

1、键合解键合设备：应用于超薄晶圆加工，主要为减薄以及背部工艺（光刻、刻蚀、电镀等），性能稳定，在快速键合、分离的同时，降低破片率。根据不同的键合胶类型，可直接选择工艺方案，减少实验时间，实现生产自动化。 2、激光解键合设备：UV激光解键合是使用UV波段激光，通过透明载片，照射扫描整片临时键合后的晶圆组。当解键合层材料在一定阈值能量激光照射后，变性后部分分解为气体，随即打开键合界面，完成晶圆解键合。UV波段激光发热量小，可理解为常温解键合工艺。解键合应力低，是50um以下薄晶圆解键合更安全。



宁波尚进自动化科技有限公司

10D35

BRT6000Plus全自动
球焊键合机

BRT6000Plus全自动球焊键合机是一款平面焊线机型，可为大规模集成电路市场提供引线键合解决方案，设备适用于分立器件、IC、LED、微波组件、激光器和光通讯器件等。芯片体积变小，键合密度越来越高，这就对焊线精度和焊线速度提出了更高的要求，BRT6000Plus键合精度为 $\pm 2\mu\text{m}@3\sigma$ ，键合速度也越来越快，每线速度达到了45ms。



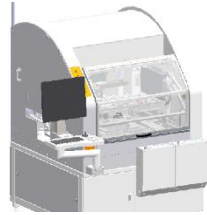
固晶机

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

10C27

固晶机

一、主要应用：1、高精度，多芯片，复杂工艺 2、内存，工业激光器，光通讯，激光雷达，CIS，MEMS，IGBT 二、主要优势 1、高精度：位置 $\pm 5\mu\text{m}$ ；角度 $\pm 0.1^\circ$ 2、多芯片：全自动更换晶圆，顶针，吸嘴 3、高柔性：模块化，支持多种吸取固晶方式；①来料吸取方式：晶圆，华夫盒，凝胶盒，送料机；②固晶方式：画胶，蘸胶，蘸助焊剂，固晶，共晶，倒装 三、设备尺寸和重量：长 x 宽 x 高 = 1160mm x 1225mm x 1750mm；净重 = 1300Kg。



微见智能封装技术（深圳）有限公司

10C35

多功能高精度固晶机MV-15D

微见智能MV-15D同时具备共晶，蘸胶，点胶，UV等工艺能力，支持蓝膜，Gel pack/waffle pack，轨道等上下料方式，支持多芯片应用，可自动更换大于13个不同类型的吸嘴。灵活的应用软件系统支持不同产品应用，工艺应用自由切换，不需要额外的软硬件校验。兼容COC/COS，COB，BOX等各种封装形式。该设备可广泛应用于光通信、激光雷达、5G 射频、商业激光器等多个领域，是芯片封装过程中不可或缺的工艺设备。



半导体设备

东莞市耀野自动化有限公司

10C26

高精度固晶机（3微米）

固晶精度3微米(3Sigma)，兼容点胶和共晶工艺，兼容晶圆环和料盒，可以同时安装6个晶圆。

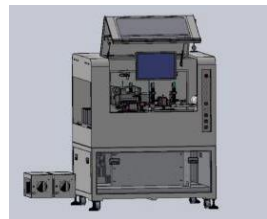


深圳市大成自动化设备有限公司

10D29

高精度固晶机

三视觉TO固晶机是一款用于光通信封装行业的专用设备，可把阵列方式排列附设于蓝膜上的管芯直接固定到管座指定位置上。主要机构为取晶视觉校正移动式直线马达工作台，固晶视觉校正移动式旋转直线马达工作台，晶环上下料机构，管座模块上下料机构，点胶机构，取晶升降摆臂及顶针机构。主要功能，全自动上下料，能够自动吸取放置在取晶工作台中的管芯，通过固晶旋转伺服马达，调整角度使管芯准确固定在管座上。该设备采用二次视觉校正，排布精准，速度响应快，运行可靠，自动化程度高，可一人多机操作，能够节省人工工时及人工成本。



试验机 / 芯片测试机

广东莱伯通试验设备有限公司

10A28

综合环境试验机

我们一直关注可靠性试验技术的最新发展,非常重视提高可靠性试验设备技术。“环境仿真”的要求也使客户认识到由一家供应商提供振动台和试验箱以实现完整综合试验的重要性.我们可以依据客户不同的试验需求,提供范围广阔的综合环境试验系统,如三综合、四综合试验设备方案、多轴振动试验系统和最新试验技术。



海拓仪器（江苏）有限公司

10C32

加速寿命试验机（HAST）

HAST加速寿命试验装置能够评估电子元器件、PCB、芯片产品等在高温、高湿，高压条件下对环境的抵抗能力，通过加速其失效过程，加速因子在几十到几百倍之间，此类极端的加速模拟可靠性测试，便于确定产品或器件的极限工作条件，更容易提前发现产品失效模式，并目缩短产品或系统的寿命试验时间，为量产验证赢得时间。



河北圣昊光电科技有限公司

10D51

LD芯片测试机

LD芯片测试机用于对LD芯片的电气和光学特性进行检测、判定与分选。主要包含DFB芯片低温/高速双温测试机、DFB芯片高频特性测试机、EML芯片测试机、COC特性测试机和大功率芯片测试机。该系列产品具有测试速度快、温控精度高，测试数据的再现性和相关性稳定可靠、数据准确等优点。发散角测试（选配）：快轴发散角 测试范围:±60° 慢轴发散角 测试范围:±60° 分辨率: 0.072°。电机驱动测试模式：（1）普通LD（DFB）模式（2）LD+EA模式（3）LD+SOA模式（4）LD+EA。



镭神技术（深圳）有限公司

10C79

芯片级测试设备——全自动工业激光器COS测试机

是一款面向工业激光器COS量产应用的测试机。可进行LIV,光谱, PER,远场的自动化测试。自动上下料,上料过程中自动识别芯片ID,与测试数据进行绑定,下料可根据测试结果分BIN下料到不同料盒。自研的大功率高速源表可提供100A的驱动能力。双工位并行测试, HPU提升一倍,平均单颗COS测试时间仅需10s(根据测试参数不同,测试时间会有差异)。



半导体设备

贴片机

芬泰电子（上海）有限公司

10C622、10C623

亚微米贴片机

全新的 FINEPLACER® lambda 2 以其广受赞誉的第一代 lambda 为基础，将在精密芯片键合和先进的芯片封装方面为光电组件和更多产品设置新的标准。完全修订的贴片平台可以很容易地针对工艺研发或原型设计的广泛应用进行配置。大量的过程模块选项和现场改造能力保证了最大的技术灵活性，以保护您的投资面临不断变化的挑战。



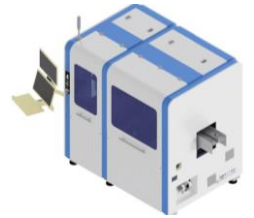
半导体设备

苏州猎奇智能设备有限公司

10C53

HS-DB2000 高速贴片机

HS-DB2000 是一款针对大批量工业化生产的高速多芯片贴装设备。配备可自由调节宽度的输送系统与其他设备无缝对接；搭载6英寸晶圆上料系统、自动换晶圆装置和自动换吸嘴装置，满足客户多芯片贴装需求。模块化设计使其具备灵活定制能力。智能校准与数据管理系统，使设备具备工艺追溯与管理的能力，同时操作更加便捷。



深圳市锐博自动化设备有限公司

10C76

自动点胶贴片机 DB-560P

DB-560P是COB/COC制程中将基底(PCB或其他待加工材料)与芯片，经过点胶工艺键合的生产设备。



北京三吉世纪科技有限公司

10D61

MRSI高精度贴片机

全自动、高速、高精度、灵活多功能的贴片系统。为激光器、探测器、调制器、AOC、WDM/EML TO-Can、光收发器、LiDAR、VR/AR、传感器和光学成像等产品的研发、小到中等批量生产，直至大批量生产提供“一站式”解决方案。为所有级别的封装提供最有效的系统和组装解决方案，其中包括晶片芯片(CoW)、载体上芯片(CoC)、PCB、TO、和管壳封装。



减薄机/贴装装备

米艾德精密技术（苏州）有限公司

10C73

高精度微模块贴装固化线

可实现功能：自动画银胶 自动画UV胶 黑胶补强 UV胶点光源固化 UV胶面光源固化 行业应用：适用于各种微模块-无源器件、传感器模块、激光器模块、VR/AR等自动组装；对于光通讯行业，兼容100G/200G/400G产品半成品、隔离器、LENS、潜望镜、Z-block等玻璃件组装。关键参数：最高贴装精度 $\pm 6\mu\text{m}$ 最高贴装角度 $\pm 0.1^\circ$ 贴装压力30-2000gf 可调 单一件3S/Pcs 良率 $>99\%$



半导体设备

恩纳基智能装备（无锡）股份有限公司

10D31

T18高精度智能贴装装备

应用领域：适用于光模块VCSEL、TIA、PD、MPD等芯片类高精度固晶硬件配置 1、设备最高精度达 $\pm 3\mu\text{m}@3\sigma$ ，配置高精度校准平台及底部相机，芯片外观检测功能，芯片位置及角度校正功能 2、具备双工作平台，采用点、画、蘸胶独立控制系统，胶量控制更加精确可靠，可根据客户需求定制 3、通用式自动上下料平台、适用于不同类型的Wafer、Tray等定制类型料盘 4、采用音圈电机可自动校正焊头、确保贴片过程中力控的稳定性 软件功能 1、高精度芯片搜索平台、自动扩晶系统 2、采用多款配置



北京创世杰科技发展有限公司

10B36

全自动高精度多功能贴装系统

T-8000-G贴装系统是一款全自动、多功能、高精度、高效率的贴装设备。该设备主体采用大理石框架结构，大尺寸贴装区域700 X 500 mm 支持自定义区块划分及夹具配置；支持2”-12”晶元拾取；X和Y轴使用线性马达驱动设计，采用精度为 $0.1\mu\text{m}$ 的线性光栅编码器，使得它在总体复合精度高达 $2.5\mu\text{m}@3\sigma$ 同时拥有了较快响应速度；压力范围从15g到800g(可选15g到5Kg)。该设备拥有众多可选配置。



苏州博宏源设备股份有限公司

5C21

减薄机

主要用于硅、锗、石英、砷化镓、陶瓷、蓝宝石、碳化硅等硬脆材料的精密减薄，也适用于集成电路、分离器件、LED芯片等的背面减薄。通过使用细目磨轮可直接对蚀刻表面和抛光表面实施研削加工，减小晶片之间的厚度偏差，提高晶片内的TTV(平面度)。 1、采用触摸界面及PLC控制，开放式的图形操控界面，充分发挥机械硬件性能； 2、具有在线测量功能，重复精度 $\pm 0.5\mu\text{m}$ ； 3、有单头、双头等多款设备； 4、可选配MES通讯单元，可实现加工工艺数据的抛转及上传下发。



抛光机

湖南天创精工科技有限公司

3D32

超精密抛光机床

主要有小磨头抛光机床、磁流变抛光机床、离子束抛光机床和定制化抛光机床。可加工的材料包括但不限于铝、微晶、ULE、熔石英、BK7、K9、蓝宝石、SiC、单晶硅、锗以及其他光学材料。可加工面形有平面、球面、非球面和自由曲面等。小磨头抛光机床面形精度RMS优于 $\lambda/50@ \lambda=632.8\text{nm}$ ；表面粗糙度可达 0.5nm 。磁流变抛光机床面形精度RMS优于 $\lambda/100@ \lambda=632.8\text{nm}$ ；表面粗糙度优于 1.0nm 。离子束抛光机床面形精度RMS和表面粗糙度均可达亚纳米精度。



半导体设备

坂口电子机械（上海）有限公司

5E76

平面研磨机抛光机

致力于薄物高精度研磨抛光设备的研究与应用，广泛应用于光学玻璃、陶瓷基片、液晶显示、LED蓝宝石衬底、电子材料、半导体材料（硅片，锗片、碳化硅、砷化镓、氮化镓等）以及金属和非金属易碎的精密零件的研磨和抛光。



四川至臻精密光学有限公司

5C60

机器人抛光机

基于时间维度调制的面形加工技术 实现位置浮动抛光力恒定的加工 集三种抛光头自由互换 可加工精度：PV<100nm，RMS<12nm 可加工材料：常规光学玻璃（石英、微晶、K9等）、红外光学材料（硅、锗、等）、金属（铝、不锈钢、钛合金等）、晶体材料（YAG、单晶碳化硅等）、碳化硅、其他 可加工形状：常规光学元件（平面、球面、棱镜）、复杂光学元件（对称非球面、离轴非球面、柱面）、特殊光学元件（超薄元件、板条元件、半球元件、保形元件、相位板、自由曲面、其他形状元件）



长沙埃福思科技有限公司

3B67

精密光学离子束抛光机

埃福思科技离子束抛光机采用创新设计的双室结构与卧式加工方案，拥有以下加工特点：高精度、高确定性、非接触式加工、无边效应、不产生表面/亚表面损伤；工件立式、装夹操作安全；离子源卧式安装，避免溅射；具备A、B、C等多款机型可选；配套功能强大的工艺计算与控制软件（驻留时间优化、加工预测、加工分析、一键开机、一键停机、定时预约、加工保护、批量加工、自动日志、远程协助等）；配置3坐标测头，具备工件智能定位功能。针对常规光学元件，加工精度RMS优于 1nm 。



研磨机

苏州博宏源机械制造有限公司

5C21

32BF精密双面平面研磨机/抛光机

主要用于半导体硅片、石英玻璃、蓝宝石、蓝玻璃、陶瓷片、晶体及其他硬脆材料的高精度双面研磨/抛光，尤其对于大尺寸、超薄工件的加工具有明显的优势。采用拉力传感器及电气比例阀，PLC实现压力闭环控制，压力控制精准 下盘采用流体轴承支撑技术，运行平稳，终身免维护，对于大尺寸超薄工件的加工有明显优势 四电机单独拖动，工艺参数（速度、压力、时间等）设置具有配方功能 可配套在线厚度控制装置，有效防止爆盘并可实现在线厚度控制 具有供液系统流量在线监控功能 可选配MES通讯单元，可实现加工工艺数据的抛转及上传下发。



半导体设备

东莞金研精密研磨机械制造有限公司

5D01

双面研磨机KS25D

主要用于光学玻璃、晶体、石英晶片、蓝宝石玻璃、铌酸锂、砷化镓、陶瓷、片铁氧体、硅片、阀板、阀片、摩擦片、刚性密封圈、气缸活塞环、油泵叶片等金属及非金属硬脆材料的双平面研磨及抛光。设备特点：采用日本“SMC”气动元件，分段精密加压控制，适合粗磨、中磨、精磨、抛光等工艺 技术参数： 型号：KS25D 磨盘直径（mm）上下磨盘640*235，磨盘转速（r.p.m）3-45 游星轮参数Z=108/M=DP12 游星轮数量5 总功率(KW/380V)8.3 重量（KG）2300。



深圳西可实业有限公司

5C15

SM724-5A 双面研磨机

本机型为四电机拖动的双面研磨设备，可装载5个28B的游星轮 主要用于碳化硅、蓝宝石、砷化镓、陶瓷片、晶体、半导体等硬脆材料平行平面的高精度双面研磨加工，也可用于手机面板玻璃、车载玻璃及各种触摸屏面板的双面研磨加工；尤其对于大直径的加工具有明显的优势。



沈阳和研科技股份有限公司

10C65

全自动晶圆研磨机-HG5260

HG5260是一款二轴三研磨台盘、晶圆自动传送和上下料的全自动研磨机，装备高刚性气浮主轴，四轴洁净室专用机械手，大量程高分辨率测厚仪等，机台兼容8/12inch两种主流晶圆的背面研磨，实现无需硬件更换的自动尺寸切换功能。



清洗机

江苏晶工半导体设备有限公司

2D058

全自动单片晶圆清洗机QX-2000

全自动单片晶圆清洗机(QX-2000)设备，主要用于清洗SIC衬底/外延表面及背面的尘粒，金属污染物以及其他有机物，设备配备刷洗工位和清洗工位，先用PVA刷子刷洗，配合化学液清洗，经烘干后可有效去除晶圆表面的有机物、颗粒、金属离子等残留物。适用于清洗6、8英寸SIC衬底。



半导体设备

中科光智（重庆）科技有限公司

10A39

真空微波等离子清洗机

我们的设备产品主要用于半导体或光电芯片的封装工艺以及其他先进工业制造，包括微波等离子清洗机、真空回流焊炉和惰性气体手套箱。其中等离子清洗机用于材料微观表面净化、活化、改性等处理，真空回流焊炉用于高功率芯片与电路基板之间的无空洞回流焊，惰性气体手套箱用于军用级电子元器件封装的环境气氛控制（配套气密性封焊设备使用）。



宁波润华全芯微电子有限公司

10D76

湿法清洗机

机台可实现多尺寸兼容，可应用于先进封装，MEMS,功率器件、射频集成电路、面板显示、光通讯、科研等



深圳市崧茂科技有限公司

1E31

Wafer清洗机

Wafer清洗机具有超强的清洁能力，具有在线循环清洗、占地面积小、使用超纯水清洗无污染的特点。



划片机

合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司

10D63

12英寸双轴全自动晶圆划片机-SD1222S

一款12英寸双轴全自动晶圆划片机该机实现晶圆从装片、对准、切割、清洗、解胶到卸片的全自动化操作。搭载大功率对向式进口双主轴，软件自主设计，自动化程度高，可满足客户各种加工需求，为客户提供高效、高质量、低成本的切割体验。主要应用于氮化铝晶圆、氮化镓晶圆、硅基晶圆、碳化硅、石墨衬底、半导体化合物等材料切割。



半导体设备

江苏京创先进电子科技有限公司

10B52

AR9000 12英寸双刀精密自动划片机

由京创先进自主研发的全新双轴全自动减薄机，主要用于8-12寸半导体晶圆的全自动减薄加工。可用于硅，氮化硅，磷化铟，砷化镓，薄膜铌酸锂，碳化硅，石英及玻璃等材料的减薄。



深圳市纬迪科技有限公司

10D81

WAD3900双轴精密划片机

1.双轴切割模式，效率比单轴切割产能提高80%以上； 2.主轴对装龙门结构，双刀间距最小24mm,双轴切割工艺适应范围更广； 3.可以满足最大310mmx310mm材料的高精密切割加工； 4.重复定位精度0.001mm； 5.可选倍率双显微镜视觉系统，工艺适应范围广； 6.触控教学式GUI，多片预切割模式，程序编辑简单便捷； 7.自动对准、自动切割、自动刀痕检测功能，减少工作人员工作量，有效提 生产效率； 8.选配功能：BBD刀片破损检测、NCS非接触测高。



河北圣昊光电科技有限公司

10D51

LD/PD芯片划片机

LD/PD芯片划片机是主要用于化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟等）芯片在常 温条件下的对位、相机定位，同时完成砷化镓芯片的划切功能。划刀荷重分段测量，更稳定，更精确的表示当前荷重，自动模式和手动模式相机辅助效果良好。



光谱仪

忆玺智能科技（杭州）有限公司

4A007、4A008

UV-VIS TE制冷光谱仪

YSM-8104系列高性能TE制冷型光谱仪，采用了滨松公司先进的背照薄片式制冷型面阵CCD，提供1024像素和2048像素两个版本，具有非常好的科研级灵敏度。其优化的低噪声电路系统，采用了18位A/D转换器，再配合优秀的CT光学机械结构，大大提升了光谱仪的信噪比、灵敏度以及热稳定性，非常适合拉曼和荧光等弱光谱信号的测量。



半导体设备

上海如海光电科技有限公司

4C032

Spider2000便携式二维拉曼成像光谱仪

该产品采用如海光电自主研发的科研级微型共焦拉曼光谱仪RMS2000作为拉曼内芯，从而使得它拥有高灵敏度、高分辨率、强穿透能力以及较好的抑制荧光干扰能力。优化的光路设计可使得拉曼激光光束在通过长焦显微物镜后最小光斑可达到微米级别，可精确采集微米级样品的拉曼光谱。采用了高精度二维自动化移动平台，可实现自动扫描mapping成像功能；配备了专门为拉曼系统设计的物镜，使得激光光斑接近衍射极限，克服了普通拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际最佳焦面的问题。



河南雷神光电技术有限公司

4D025

便携式傅里叶红外光谱仪

LSPEC 5010 便携式傅里叶红外光谱仪是一款具有较强的适应性，可以适应当前绝大多数应用的使用环境。仪器采用双角镜扭摆式干涉仪结构，具有测量精度高、稳定性好、使用寿命长等特点。仪器具有完全一体化且可靠的通用采样功能，轻松进行测量并提供各种便携配件，是实验室和现场测试环境的理想选择。



岛津企业管理（中国）有限公司

7B73

岛津傅立叶红外光谱仪IRTracer-100

适用于红外波段光学元件的透过率，反射率、半导体元件镀膜分析。



蚀刻机 / 等离子去胶机

无锡吕文微电子科技股份有限公司

2A107

Strip去胶系列设备

单腔单片或两腔Twin wafer去胶设备，配置高精度传送手臂，电感耦合等离子体源，高精度控温热板模块等。具有操作简单、占用空间小，产能效率高，耗材成本及运营成本低等优点。广泛应用于4英寸~8英寸硅基/碳化硅/氮化镓/砷化镓等产线的去胶。



半导体设备

科毅科技(东莞)有限公司

4B007、4B008

真空微波等离子去胶机

晶圆尺寸：4吋-12吋 微波电源：功率3KW,频率2.45GHz 容积：100L/450×450×450mm 控制系统：PLC 气路配置：标配氧气、氩气两路工艺气体（可定制CF4气体）



宁波润华全芯微电子设备有限公司

10D76

去胶剥离机

设备为全自动机台，可自动完成去胶、金属剥离工艺，药液可循环利用，可应用于先进封装、MEMS、功率器件、射频集成电路、面板显示、光通讯、科研等。



北京哲勤科技有限公司

7D05

IoN Wave 10 微波
等离子体去胶机

IoN Wave 10是PVA TePla在微波等离子体处理工艺中的最新产品。该设备尺寸适中、性能先进。IoN Wave 10配置最新的性能出色的组件和软件，对工艺参数进行精确控制。实现最严格的质量控制。IoN Wave 10安装和维护简单。微波等离子技术，提供了极高的光刻胶灰化速度，降低了在静电放电中的风险。应用：光刻胶灰化 去除牺牲层（PI等）去除底膜 晶圆和衬底的清洁 刻蚀钝化层（氮化硅等） SU-8灰化 去除聚合物 边缘刻蚀(去除PSG层) 失效分析中的器件/PCB开封。



切割设备

深圳锦帛方激光科技有限公司

2C036

30W紫外切割设计

紫外激光器最常见的是波长355nm的产品，具有短波长、短脉冲、光束质量优异、高精度、高峰值功率等优点。紫外激光器与绿光、红外相比，具有更小的热效应，随着激光波长的变短，各种材料都具有更高的吸收率，所以紫外激光又被称为“冷光”，其加工材料又被称为“冷加工”。



先进微电子装备（郑州）有限公司

10D706、10D707

6110 半自动单轴6吋
晶圆切割机

ADT 6110是一款高精度，高性能单轴半自动切割机。占地面积小到极致，结合全新设计的操作系统，提供高效、低使用成本的切割体验。标准配置2.2kw高转速主轴，θ轴采用DD马达驱动，并搭载自动校准，自动切割，刀痕检查功能。可选配搭载残片形状识别，指定检查位置一键直达等功能。适用于精密加工晶圆、陶瓷、玻璃、碳化硅等各类半导体材料。



半导体设备

深圳市韵腾激光科技有限公司

2A070

全自动SD卡激光切割设备

机台特点：1、精密型设备，占用空间小，性能稳定。2、双光路系统同步作业，加工精度更精准。3、独创的光学系统，光束质量好，切割效率高。4、可实现产品自动上料，检测，切割，下料等功能。



唐山晶玉科技股份有限公司

5B88

多线切割机YBDX5056-III

YBDX5056-III多线切割机主要用于金刚石线切割单晶硅、陶瓷、玻璃、贵金属等硬脆材料的切片加工。该设备具有精密温度控制系统，切片精度高，翘曲度小，切片质量稳定，切割成本低。



钻孔&固化设备

锐莱特精密光电技术无锡有限公司

2A030

玻璃激光钻孔机

RayGlass C0906系列玻璃激光打孔机具有如下特点：1、打孔速度快，精度高，稳定性好，品质高，成品率高；2、可直接加工圆孔、方孔、阶梯孔、异型孔、任意曲线图形等，图形完全由电脑程式化设定；3、玻璃最大尺寸可达900*600mm；4、操作简单、效率高、玻璃无需用水冷却；5、可直接加工多种玻璃、石英等透明脆性材料。



半导体设备

深圳市韵腾激光科技有限公司

2A070

FPC激光钻孔设备

机台特点：1、可实现卷对卷、片对片的加工方式。2、采用超快激光钻孔，可加工通孔、盲孔，精准而高效。3、可选上下料方式，自动放板或人工放板4、四轴联动，可实现任意尺寸的无缝衔接切割。



广州市邦沃电子科技有限公司

1A75

全自动无极灯UV固化设备

邦沃科技研制的全自动无极灯UV固化设备，在线式工作模式，采用全波段无极灯光源，可固化各类UV材料，兼容种类繁多的产品紫外光固化。广泛应用于3C行业，新能源电池生产，PCB三防胶固化，电子半导体，光通信行业，医疗及生物领域，印刷涂敷等各种行业领域。



深圳市海特奈德光电科技有限公司

1D33

自动化UVLED固化设备（显示屏）

自动扫码上传MES系统+UVLED固化+自动检测UV能量+自动上下料+治具回流全自动化，工业4.0对接 防产品漏UV固化 电流检测，能量检测。



显示设备

梭特科技股份有限公司

2D176

分混排一体机

ST-668之用途在于，依据 mapping数据，电脑预先计算混Bin的信息，将粘贴于薄膜上之wafer晶粒依指定之坐标逐个取出，将之整齐排列于特定的Bin Frame蓝膜(或是基材)的特殊坐标位置上。达到分选、混Bin与精准排列同时完成的目的。其基材需先贴覆黏性薄膜，或可沾附黏着。品粒放置位置需有对位记号，广域精度可达10um。



季华实验室

2C115

超高分辨率OLED发光层像素
喷墨打印成套验证装备

200mmX200mm OLED 发光层像素喷墨打印验证装备主要用于对OLED发光层像素喷印工艺、喷孔控制算法、墨路稳定性等进行验证，指导后续OLED 4.5代线发光层像素喷墨打印装备的设计工作。该OLED发光层像素喷墨打印验证装备能够成为OLED喷印行业重要的试验设备，对工艺、墨水材料、供墨系统、喷印控制算法、喷印环境等喷印的重要因素进行测试，能够大幅提升企业的工艺设计效率，同时也能成为从事相关研究的高校及科研院所的试验测试平台，帮助其开展科研探索。



卫是（上海）电子有限公司

7D15

JV33真空计显示器

JV系列真空计显示器用于显示和控制wisen的真空规管,与wisen真空规JPC、JPR、JPM系列一起用于总压强的测量与控制。JV系列显示器完美兼容INFICON各型号真空规管。



苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2D160

数字化直写光刻设备

苏大维格深研数字光场调控新机理，提出了数字化三维直写光刻系统的新构架、新算法，成功开发出多种型号与功能的数字化紫外直写光刻系统，覆盖4-120吋幅面。应用领域：泛半导体、光子器件、表面功能材料先进传感、新型显示、公共安全、二维材料、柔性电子等。



检测设备

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

10C27

全自动芯片四面外观检测设备

主要应用于：光通讯、高功率激光芯片等单芯片外观检测。1、设备尺寸：L1800*W1250*H1900mm。2、检测缺陷类型：脏污、划痕、崩边、异色、解理纹、膜层脱落等3、瑕疵判定方式：基于深度学习的缺陷检测+传统算法辅助（瑕疵大小、面积、比例等可自由设定）①上表面（P面）最小瑕疵检出：3.6um（选配：2um）②下表面（N面）最小瑕疵检出：5um ③端面（HR/AR面）最小瑕疵检出：0.5um ④选配：端面（HR/AR面）：微弱解理纹专项



半导体设备

珠海诚锋电子科技有限公司

10A23

CFW380-后段工艺光学检测设备

应用场景：OQC, 切割后检测, 扩膜后检测 专用切割道检测算法：1.划片道崩边宽度和深度 2.切割道扩开后的宽度(die间距) 3.扩膜后两侧切割道分别的宽度(检测是否划偏)

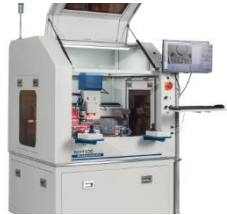


深圳市德瑞茵精密科技有限公司

12D15

琥克A100 新能源动力电池粗铝线键合拉力检测系统

高精动态非破坏性测试 直接对客户产线自动化系统 超高效率检测能力



北京量拓科技有限公司

3D23

ET-S8100A 半导体薄膜检测系统

随着半导体行业不断实现摩尔定律，薄膜厚度越来越薄，芯片制造商必须实施有效的超薄电介质材料的过程监测。椭圆偏振法是一种高灵敏度、非破坏性、非接触式的测量技术，能够用于任何透明和半透明介质。它可以测量从单原子层的纳米到几十微米的宽范围厚度区间。椭圆偏振法可以确定单层和多层的厚度，可以在一次测量中同时分析多层，并提取每层的膜厚。此外，它还允许通过提取n和n数据，从深紫外到近红外的宽光谱范围内来绝对表征材料的光学特性。



检测设备

苏州瑞霏光电科技有限公司

3D25

晶圆翘曲应力测量仪

晶圆翘曲应力测量仪Stress Mapper具备晶圆三维翘曲（平整度）、薄膜应力、宏观缺陷成像等检测功能，适用于半导体晶圆生产、半导体制程工艺开发和玻璃及陶瓷晶圆生产，以简单、精确、快速、可重复的测量方式，对各种晶圆的表面进行一次性非接触全口径均匀采样测量，另可附加晶圆加热循环模块。



半导体设备

西安恩科微纳光电科技有限公司

3E30

微纳轮廓检测仪

非接触检测表面微纳及缺陷，台阶高度，划痕深度，钢球粗糙度等。

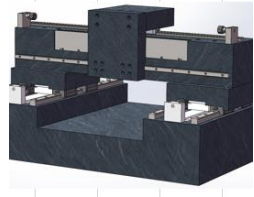


山东善能精密机械有限公司

5C73

龙门式高精度自动光学检测光机

三轴采用直线电机+光栅尺+直线导轨组合传动方式，有效保证定位精度的同时可以减小传动装置运作时对设备测量精度产生的精度，从而获得更准确的测量数据。每组直线导轨自身直线度、相互平行度最高可以达到0.002mm。可广泛应用于高精密加工、检测领域



微纳科仪（北京）科技有限公司

2A122

Sentronics晶圆测量系统

晶圆厚度测量系统是德国SENTRONICS公司高性能的半导体用半/全自动晶圆厚度测量系统，该系统集成了红外光谱干涉测量技术，光学干涉技术及光学反射技术的测量探头，广泛用于半导体Wafer Manufacturing, FEOL, BEOL 及Wafer Level Packaging领域，SENTRONICS以其精准的测量能力，非接触的测量方式，快速的测试速度，上下双探头符合SEMI标准的测试方式，使得该设备在半导体，MEMS，在化合物外延领域测量晶圆厚度拥有很高的市场占有率。



轮廓仪

布鲁克（北京）科技有限公司

3A42

三维光学轮廓仪 ContourX-500

ContourX-500 光学轮廓仪是全球功能最全面的自动化台式系统，可快速完成非接触式三维表面计量。ContourX-500 具有卓越的 Z 轴分辨率和准确度，并具备布鲁克落地式白光干涉 (WLI) 仪器广受业界认可的所有优势，而占地面积更小。该款轮廓仪可轻松自主配置，适用于从精密加工表面和半导体工艺的质量保证/质量控制 (QA/QC) 计量到眼科和机电系统 (MEMS) 器件的研发表征等广泛的复杂应用。



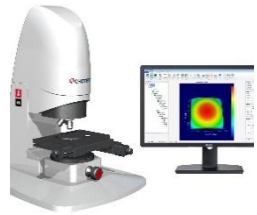
半导体设备

深圳市中图仪器股份有限公司

3A58

光学3D轮廓测量仪

光学3D轮廓仪是利用光学显微技术、白光干涉扫描技术、计算机软件控制技术和PZT垂直扫描技术对工件进行非接触测量，还原出工件3D表面形貌宏观微观信息，并通过软件提供的多种工具对表面形貌进行各种功能参数数据处理，实现对各种工件表面形貌的微纳米测量和分析的光学计量仪器。



上海坤视珩光学精密仪器有限公司

3D52

S neox 3D光学轮廓仪

S neox 是高性能非接触式 3D 光学轮廓显微镜系统，专为亚纳米、纳米和微尺度级测量而设计，具有先进的检查和分析功能，在设计、功能、效率和性能方面均优于现有的光学 3D 轮廓分析显微镜。除此之外，它最令人印象深刻的特点是它无与伦比的速度。借助新的智能独特算法，一切都变得更快。数据采集速度为 180 fps。S neox 将标准测量的采集速度较之前提高 5 倍，这使其成为市面上最快的区域测量系统。



优尼康科技有限公司

3B22

P-7 探针式表面轮廓仪/台阶仪

P-7支持从几纳米到一毫米的台阶高度测量，适用于生产和研发环境。该系统可以对台阶高度、粗糙度、翘曲度和应力进行2D和3D测量，其扫描可达150mm而无需图像拼接。



测量仪

思显光电技术（上海）有限公司

3B75

共焦三维轮廓测量仪

通过光谱共焦位移传感器搭载高精度磁驱电动台，扫描三维轮廓



内蒙古瀚泰微科技发展有限公司

6D48

CT300表面形貌测量仪

CT300是一款定制式；多兼容非接触式形貌测量设备，可扫描最大12英寸晶圆和其他大型基板和部件。凭借亚微米的测量精度，能够测量不同的材质，结构，表面参数，几乎涵盖所有类型的表面形貌，是测量平面度，膜厚，关键尺寸等参数的理想设备。设备拥有315×315mm扫描行程，可同时装备多型号白光共焦传感器，具有高达4 kHz的数据采样速率，满足各种高端形貌测量应用。主要用于大尺寸产品表面测量，半导体制造及封装、检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、MEMS器件等超精密加工行业。



半导体设备

广东万濠精密仪器股份有限公司

3D83

影像测量仪

适用于二维坐标测量为目的的应用领域，在机械，电子，仪表，塑料等行业被广泛应用

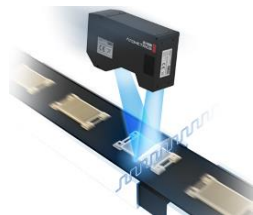


铂石智能科技（深圳）有限公司

3B35

AM 7000白光干涉三维形貌测量仪系列

优可测AM系列是一款国产自主品牌的三维形貌测量仪，专注于半导体、光学、PCB、材料、刀具、医疗等行业领域，提供粗糙度、台阶、表面形貌、三维形貌比对、高度、表面轮廓等微观测量，精度达0.002纳米！



真空镀膜设备

成都国泰真空设备有限公司

7C31

光学真空镀膜机

GT1150光学镀膜机优选节能环保无油的分子泵配置，抽速快且稳定性好，配置自主专利RF射频离子源，性能超越同类进口组件，使产品膜层致密度、温漂问题得到本质上的改善；集成透射/反射式直控光控，可支持宽范围波长(400~2400nm)，具有高精度（监控波长精度<1nm,重复性<0.25nm），强力支持生产高品质的IR-CUT和带通滤光片等产品；集成自主研发ACS镀膜系统，实现熔料、镀膜等全流程自动化和可视化，完善的工艺EXCEL文件管理和过程数据和报警等日志自动保存，方便产品质量管控和问题追溯。



半导体设备

广东汇成真空科技股份有限公司

7C53

柔性电子卷绕真空镀膜设备

该系列设备采用直流磁控溅射、射频/中频反应磁控溅射等技术灵活组合，模块化概念和独特技术确保高质量生产。在PET、PI、PC、COP等柔性聚合物、金属带等带状卷材表面进行连续镀膜，镀铝、钛、铬、铜、镍铬、镍、银等金属材料，TiO₂、Nb₂O₅、SiO₂、ITO、SiAlO_x、MoO_x等氧化物。



杰莱特（苏州）精密仪器有限公司

7C25

离子束溅射镀膜机

离子束溅射镀膜机应用于光通讯滤光片（Lan-WDM、MWDM、DWDM100G）、生物医疗荧光滤光片、半导体芯片、紫外膜、高损伤阈值激光膜等的批量生产。

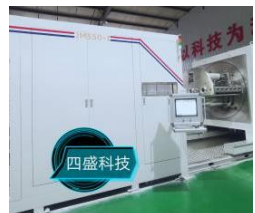


成都四盛科技有限公司

7A55

溅射卷绕镀膜机

四盛科技---卷绕式磁控溅射真空镀膜机：柔性带材卷绕镀膜，独特的单室双主辊设计（满足2种材料的同轴溅射），独创8辊同步运行薄膜走向平稳无折皱，且全部采用德国西门子伺服电机+伺服控制器+PLC控制处理，整个卷绕系统采用闭环张力自动控制，磁控靶设有磁场屏蔽板并采用独立的均气环设计，配美国AE电源溅射功率平稳，真空系统全部采用进口泵配置，且溅射区采用独立区域气氛设计抽速可控可调（稳定气流），整机集成优化度高、工控电脑人机界面自动化控制稳定可靠。四盛科技是致力于研发、制造的真空镀膜设备专业制造商。



焊接设备

深圳市锐博自动化设备有限公司

10C76

超声波金属焊机 UT-400

UT-400是IGBT端子焊接制程中，加压于金属端子并通过超声波高频振动使端子与底板键合的生产设备。设备采用200*300mm载盘，通过更改载盘和少部分零件即可切换生产产品。



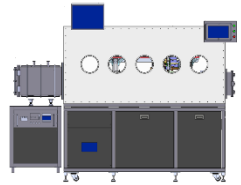
半导体设备

北京科信机电技术研究所有限公司

10C28

PXH-1 自动平行缝焊机

适用于2~150mm 尺寸的晶体和声表面波器件、光学器件、功率器件、传感器和MEMS器件的封装。焊接速率：0.1-20mm/s；焊接压力：0.5-2Kg；焊接功率：2kW；焊接盖板厚度：0.08-0.2mm；视觉定位分辨率：4.4 μ m；视觉对位精度： \pm 0.035mm（25 \times 25mm产品尺寸）；工作室露点： \leq -40 $^{\circ}$ C 漏率：符合国军标规定（GJB548B-2005）；焊接电源：逆变式脉冲焊接电源；供电电源：单相 220V、2kVA（含烘烤箱）。



深圳市紫宸激光设备有限公司

2A025

VG820RT转盘式锡膏
激光焊机

该设备采用旋转6工位激光焊接系统，在保证原有焊接效率的基础上，提升了20%以上。除此之外设备还配备转盘锡焊工作台、CC D定位、光斑整形和焊后检测等功能，为产品的自动化激光焊锡加工的稳定运行提供了保障。1.6工位并行，效率提升20%以上，适用于微小精密件焊锡；2.光斑整形功能，可根据焊盘的形状调整光斑形状；3.专用的焊接软件，操作简单，功能强大；4.视觉定位，运动精度高；5.精准的温控功能，杜绝烧伤；6.可扩展点锡/焊后检测，实现点锡后及焊接后的不良检测。



北京华奥复兴科技有限公司

4D088

热激活高真空焊接炉

该设备是用于带有吸气剂（Getter）产品的激活与封焊同时完成，同时满足高真空高温激活及低温熔封焊接。采用专用升降机构+隔热装置，充分保证有效温差，完全不影响二次盖板封焊。不同产品订制工装夹具，尺寸大，可批量化生产，尽而提高生产产值作业。产品整盘放置，采用L型夹装，上下定位精度0.02 mm。高真空可达10 -5 pa，高真空高温激活与焊接激活曲线完美。适用于红外陶瓷产品、MEMS及陀螺仪等。



半导体配套产品

友川控制技术（东莞）有限公司

10C56

精密微调滑台/自动滑台

直线滚珠加丝杆结构，通过复杂的高精度加工和组装，实现微米级定位精度的同时，体积非常小巧。还可以根据客户的个性化要求自由搭配组合。六维XYZ轴直动3轴与 θ x θ y θ z轴移轴3轴上加入自动滑台的组合。可全方向控制，结构对应单芯光纤至光纤排列或光波导及各种光学元件等所有装置的自动耦光用途。除了耦光用途以外，还可以实现6维高精度自动调整和自动对位功能，解决客户问题，提高生产效率。



东莞市鑫米达精密技术有限公司

2D001、2D002

精密手动滑台

手动滑台是一种用于工业自动化和机械加工的设备，它可以在加工过程中移动工件或工具。它的原理基本上是通过手动操作控制滑台的移动，从而实现工件定位、加工和装夹等操作。手动滑台通常由导轨、滑块、传动装置等组成，利用滑块在导轨上的低摩擦滑动来实现物体的直线定位移动。



山洋电气贸易（深圳）有限公司

10A33

兼备“力量”和“灵活性”的新系列
伺服系统“SANMOTION G”

高性能、小型化、轻量化、节能的伺服系统“SANMOTION G”系列。适用于半导体制造设备、医疗器械机器人、工作机械、食品机械等。



ISMC

10D37

Diamond Plus 系列
插针式伺服驱动器

Diamond Plus 系列插针式驱动器是一款小功率、高性能、紧凑型低压直流伺服驱动器，支持12V~60V 直流供电，最大支持 72V 直流供电，功率覆盖 0~750W 应用场景。采用插针式接口设计，便于客户做二次开发。支持标准的EtherCAT/CANopen/Modbus 通讯，配有智能化的终极调试工具，具有全中文界面，参数一键导入，图像化调试等强大功能。支持多种电机类型（永磁同步伺服电机/直流无刷电机/直线电机/力矩电机/音圈电机/步进电机）以及丰富的反馈类型增量式/绝对值/霍尔。





重点展示光电子芯片

展示范围：光芯片、电芯片

光芯片/电芯片

西安立芯光电科技有限公司

4B040

850nm 高功率半导体单模激光芯片

850nm单模产品在芯片设计、外延材料生长、前端制备工艺、后端制备工艺、封装测试分析、可靠性与失效分析等六大模块进行了系统性深入研究，突破了芯片研制过程中的诸多关键技术和工艺，成功开发了高功率、高效率和高可靠性单基横模半导体激光芯片系列产品，实现了从外延材料、芯片的完全自主可控。芯片特点：高转换效率、高可靠性、可定制化

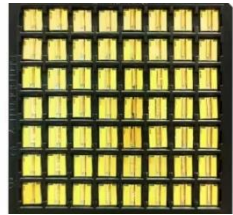


武汉锐晶激光芯片技术有限公司

4A156

高功率半导体激光芯片

高功率半导体激光单管芯片具有高功率输出、高转换效率、高可靠性、高亮度、长寿命等特点，可广泛应用于工业加工、医疗美容、科研实验等领域。



芯思杰技术（深圳）股份有限公司

11A53

25Gbps/50Gbps APD芯片

该25Gbps/50Gbps APD光探测器芯片是GSG电极结构，为正面入光的高速雪崩光探测器芯片，光敏区尺寸分别是 $\Phi 16\mu\text{m}/\Phi 12\mu\text{m}$ 。产品的主要特点是高倍增、低电容、低温度系数和高可靠性，主要用于25G PON、50G PON、5G无线和100G ER4。



陕西源杰半导体科技股份有限公司

12B51

10G&25G CWDM6 DFB Laser

应用于5G前传，面对5G前传高速率、大容量、省光纤的应用场景，该系列芯片源杰2020年国内发货量位居榜首，大批量交付给多个业内领先的光模块和系统设备厂家。



光芯片/电芯片

深圳市富泰克光电有限公司

12A13、12A26

5nm 400G/800G
数字信号处理芯片

Keystone是具有高集成度的PAM4 DSP SoC, 可实现 800Gbps光学单波100G传输, 光/电接口均支持 106.25Gbps PAM4 信令适用于DR、FR 和LR 应用。该器件支持丰富的数字信号处理功能, 包括线路侧 Tx数字预失真 (DPD)、发射预加重 (Tx FIR)、接收前馈均衡 (Rx FFE) 和决策 反馈均衡 (DFE)。采用 12mm × 13mm 封装, 集成EML 驱动器, 差分摆幅可达4.0Vpp 可直驱硅光(SiPh) 和电吸收调制激光器 (EML), 为 112G信号提供出色的信号完整性, 适用于下一代QSFP-DD800和OSFP等封装尺寸, 也支持裸die应用于CPO等场景。

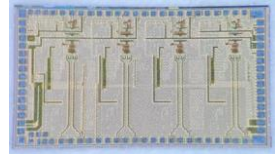


杭州芯耘光电科技有限公司

11B21

XY5351/4 & XY53A1/4
线性跨阻放大器

XY5351/4 & XY53A1/4 线性跨阻放大器是覆盖50G~400G应用的高灵敏度、低噪声和高带宽一、四通道线性TIA。它专为 26~53Gaud PAM4符号率而设计。该芯片提供从 250Ω 到5kΩ可调差分跨阻。带宽可以调整和在噪声和 ISI 之间进行权衡优化接收灵敏度配置。这些TIA 提供反向偏置电压和光电流监视器(RSSI)用于 PIN 光电二极管应用。



光
电
子
器
件

芯境科技 (上海) 有限公司

12C29

光模块DSP芯片

Credo的低功耗、高性能DSP产品拥有业界领先的传输性能, 能够为云规模、超大规模和企业级数据中心, 以及5G基础设施部署中的50G-400G PAM4光模块提供光互连, 功耗及价格极具市场竞争力。产品采用Credo专有的DSP技术和均衡技术有助于补偿光学损伤, 以实现最佳的整体系统性能、信号完整性和低功率。Credo光DSP现有单通道100G的Dove和单通道50G的Seagull两个产品系列。其中Seagull全系列可选配支持工温, 且已推出集成VCSEL/EML Driver的产品。

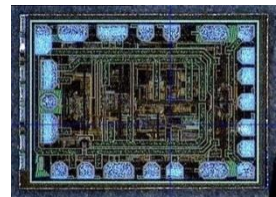


上海米硅科技有限公司

12D53

ms52000 - 应用于XGS PON的
10G 突发跨阻放大器

ms52000是高灵敏度突发跨阻放大器, 满足XGS PON 2.5G和10G网络所需要的恢复时间和突发动态范围, 支持快速自动增益控制和快速信号探测功能。





重点展示传感器

展示范围：业传感器、MEMS传感器



工业传感器

米铱（北京）测试技术有限公司

6D17

电容位移传感器及测量系统

电容式非接触位移传感器可以测量所有的导体和半导体材料，如果选择适当的控制器也可以测量绝缘材料。从而得到被测物体的位置，位移以及厚度的精确数据。电容式位移传感器具有高的信号稳定性和分辨率，在实验室和工业测量中得到了广泛的应用。例如，在生产控制中，电容传感器测量薄膜厚度和粘合剂的应用。安装在机器上，它们监控位移和刀具位置。



深圳市通瑞科技有限公司

8D79

电容式角度传感器

电容式角度传感器主要以电编码器专利技术为基础，提出了一个独特和创造性的方法来检测位置，其小型高精度、耐低/高温、真空环境、抗高振动/冲击、低电磁干扰/电磁辐射等特点，已远远超越普通的光电编码器和旋转变压器技术，其独特的优越性已在航空航天、医疗设备、汽车、电子通信等各种应用中展示。

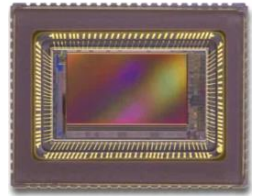


长春光光辰芯微电子股份有限公司

6B21

GMAX4002 4微米 2.4MP 高速
全局快门CMOS图像传感器

GMAX4002采用先进的4um电荷域全局快门像素以及1/1.7"光学尺寸，有效分辨率为2048(H) x 1200(V)。可被广泛应用于机器视觉、工业检测、运动捕捉、3D成像等领域。GMAX4002提供普速和高速两种版本。



传感器

善测(天津)科技有限公司

6D63

电容传感器

CDU3255是一款单通道高精度电容位移传感器,兼容善测公司所有电容传感器探头型号。设备采用9~36V供电电源,提供模拟量(电流、电压)、数字量输出接口,可进行多台级联同步采集,实现多点高精度位移监测。同时自带显示屏,可实时显示测量结果。便携式的设计和简易的操作性,使其能够进行更多场景的高精度监测。



MEMS传感器

深圳市美思先端电子有限公司

8B95

精小型冷媒传感器

美思先端精小型冷媒传感器采用NDIR非红外吸收原理，结合高精度采样电路，内置气压、温度补偿和自校准功能，能够对环境中各类制冷剂气体浓度进行实时在线监测，可广泛应用于商用空调、中央空调、制冷机组等产品制冷剂泄露检测，为用户生命财产安全保驾护航。产品特点：测量精度高；响应速度快 性能稳定可靠；内置气压、温度补偿。

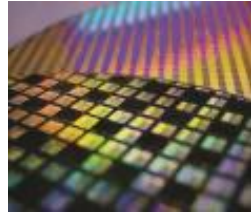
MFrontier 美思先端



苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司 6E35

MEMS晶圆流片代工

MEMS晶圆流片代工，包括硅麦克风、压力传感器、微镜、喷墨头、流量传感器、气体传感器、温度传感器、热电堆、滤波器、铌酸锂光通讯器件、生物芯片、PZT压电器件等



深圳市英唐极光微技术有限公司

6D24、6D25

二维电磁驱动型
MEMS Mirror

二维电磁驱动型MEMS Mirror，其中4mmφ规格准备进入试产，8mmφ规格正在开发中。该产品具有体积小、低功耗、宽广的FOV等特点。低串扰（两轴独立驱动），内置角度和温度传感器（压电传感器） 经验证该产品寿命长，可靠性高。已成功通过汽车可靠性测试。



CG0006AR (4mmφ)

武汉利科夫科技有限公司

6B17、6B18

高精度MEMS IMU--
LKF-MG300系列

LKF-MG300系列高精度MEMS惯性测量单元是一款高可靠、高性价比的六轴MEMS惯性传感器组合，可广泛用于以惯性导航、姿态稳定为代表的导航、控制和测量等领域。



*以上所有企业产品及展位号以现场位置为准。

找展商 查产品

搜会议 看直播



扫码并添加至“我的小程序”
方便随时查看使用



扫码添加光博君企业微信
进行行业交流群